PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-079671

(43)Date of publication of application: 04.04.1991

(51)Int.Cl.

C08L101/00 CO8L 71/02 C09J201/00 G02B 1/04 H01L 21/304

(21)Application number: 02-069569

(71)Applicant: SUETSUGU MASAO

(22) Date of filing:

22.03.1990

(72)Inventor: SUETSUGU MASAO

(30)Priority

Priority number: 01107540

Priority date : 28.04.1989

Priority country: JP

(54) THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a composition capable of reversibly changing its state between a fluid and a solid according to slight heating or cooling and suitable as a fixing agent for contact lens, etc., by compounding a polyethylene glycol compound with a water-soluble thermoplastic hvdrocarbon compound.

CONSTITUTION: The objective composition is produced by compounding (A) 40-70 pts.wt. of a polyethylene glycol compound with (B) 60-30 pts.wt. of a water-soluble polymer compound compatible with the component A, containing a monomer unit having tertiary nitrogen atom and a vinyl group or (meth) acryloyl group in the molecular structure and having a pyrrolidone group on the side chain.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

❸公開 平成3年(1991)4月4日

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-79671

®Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 8016-4 J 6917-4 J 6770-4 J 7102-2H 8831-5F C 08 L 101/00 L TA 71/02 201/00 Ç 09 J JÃQ G 02 B 1/04 21/304 H 01 L 321 H

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全15頁)

60発明の名称

熱可塑性樹脂組成物

②)特 顧 平2-69569

顧 平2(1990)3月22日 220出

優先権主張

劉平1(1989)4月28日國日本(JP)動特願 平1-107540

720発 明者 雅夫

東京都杉並区本天沼3-19-17

砂出 願 人 雅 夫

東京都杉並区本天沼3-19-17

末 次 個代 理 人 弁理士 三宅 正夫 外1名

末 次

明 ЖE

1.発明の名称

熱可塑性樹脂組成物

- 2. 特許請求の顧用
- (1) ポリエチレングリコール系化合物と、該化合 物と相溶性を有する水溶性熱可塑性高分子化合物 とを含有する熱可塑性樹脂組成物。
- (2) 上記無可塑性高分子化合物が分子構造中に3 級窒素原子及びビニル基又は(メタ)アクリロイ ル基を有する単量体単位を含有するポリマーであ る請求項1記載の無可塑性樹脂組成物。
- (3) 上記無可塑性高分子化合物が側鎖にピロリド ン基を有するポリマーである請求項2記載の熱可 塑性樹脂組成物。
- (4) ポリエチレングリコール系化合物がポリエチ レングリコールである請求項1~3の何れか1つ に記載の無可塑性樹脂組成物。
- (5) 請求項1~4のいずれか1つに記載の熱可塑 性樹脂組成物を含有するホットメルト型接着剤。
- (6) ポリエチレングリコール系化合物を溶媒とし

- て、雄化合物と相溶性を有する水溶性熱可塑性高 分子化合物の構成成分となる単量体を重合せしめ る熱可塑性樹脂組成物の製造方法。
- (7) 請求項1~4のいずれか1つに記載の熱可数 性樹脂組成物を繋止剤として使用するコンタクト レンズの製作方法。
- (8) 請求項1~4のいずれか1つに記載の熱可塑 性樹脂組成物を繋止剤として使用する半導体ウエ ハの製作方法。
- (9) 上記熱可塑性樹脂組成物を使用して半導体ウ エハを繋止するに際し誘電加熱を行なう請求項8 に記載の製作方法。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、比較的低温で軟化する水溶性の熱可 塑件操脂組成物に関する。

この熱可塑性樹脂組成物は、用途・目的に応じ て水に溶かすことのある製品の原料として有効に 利用でき、例えば、コンタクトレンズ等のプラス チック製品、半導体ウエハ等の板状製品、レンズ、 (従来の技術)

コンタクトレンズの切削研磨工程や半導体ウエハの研磨(ラッピング、ポリッシング)加工工程では、コンタクトレンズや半導体ウエハの原材料を治具に一時的に禁止する必要が有り、繁止用接着剤としてはホットメルト型接着剤が使用される場合が多い。

一般に、このようなホットメルト型接着剤としては、ワックスと云われているロジン、変成ロジンエステル、蜜蝋、パラフィン等の混合物や各種の熱可塑性樹脂組成物が用いられている。

(発明が解決しようとする課題)

トリクロロエタン、トリクロロエチレンなどが大量に使用されるようになったが、最近オゾン層破壊の環境問題からその使用が規制されるようになった。また、有機溶剤、無機薬品混合物は共に被加工物の性質に応じて被加工物の品質に影響を与えないものを選択する必要があり、万能のものではない。

一方、水溶性無可塑性高分子化合物としては、 カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、 ポリピニルアルコール、ポリピニルピロリドン等 が知られている。

しかし、これらの化合物はホットメルト型接着 剤として利用できる無流動性に乏しく、また、実際に、水溶性であってホットメルト型接着剤とし て有用な作業性を示す水溶性樹脂組成物は知られ ていない。

本発明は、かかる問題点を解決する無可塑性樹脂組成物を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明者は、上述の目的のもとに鋭意研究した

しかし、これら従来のホットメルト型接着剤の多くは軟化温度が高かったり軟化温度以上でも容易に流動化しないため、塗付時の作業性に劣る。一方、接着剤の着脱可能な融解温度を低くすると、ややもすれば接着剤の原材料と治異との把持力が弱くなり、加工工程中に接着剤がクリーブを起こし、コンタクトレンズの加工ではその加工寸法鞘度を低下させる原因となる。

さらには、これら従来の接着剤は非水溶性であるので上記の加工後に被加工物から繋止用接着剤を除去するに際し、有機溶剤或いは特定の組合せの無機薬品混合物を使用することが必要とされている。(*最新高分子材料技術総覧*、テック出版(以下「文献1」という)第269~270頁、及び、*シリコン結晶とドーピング*、丸善隣(以下「文献2」という)第25~26頁参照)。

しかし、このような有機溶剤の中には中毒、火 災、爆発などの災害を惹き起こす危険性のあるも のが多く、安全衛生上好ましくない。

このような危険性を避けるためにフロン系溶剤、

結果、ポリエチレングリコール系化合物と、該化合物と相溶性を有する水溶性無可塑性高分子化合物とを含有する無可塑性樹脂組成物によって所望の作業性を備えた水溶性の無可塑性樹脂組成物が得られることを見出し本発明を完成するに至った。

今までに、易水溶性であって、常温に近い比较 的低温の温度領域での加熱によって熱流動化し、 ホットメルト型接着剤として使えるような樹脂組 成物は知られていなかった。

一般に、無可塑性樹脂組成物はその温度上昇に 伴なって徐々に軟化し無流動するので、その温度 変化に対する剛性率の変化率は小さいものである。 これに対し、本発明の樹脂組成物はその中に配合 されているポリエチレングリコール系化合物の種類と濃度に応じた特定の狭い温度領域で大きな剛 性率の変化を示し、優かな加熱又は冷却によって 可逆的に無流動化又は固形化する点に特徴を有する。

すなわち、本発明の無可塑性樹脂組成物は、その飲化流動温度(被着物間志を手圧で容易に着脱

することが可能な温度)付近での僅かな温度の上 昇又は下降に伴い通常の概念での固体から粘性流 動体へ、また粘性流動体から固体へと可逆的に状 態変化する。

また、本発明の熱可塑性樹脂組成物は、易水溶性であり、例えば、厚さ1 mm以内のフィルム状として水中に放置するだけで容易に溶解分散し、またアルコール可溶性である点にも特徴を有する。

本発明の熱可塑性樹脂組成物を前記のような状況がある。して使用する場合に、この組合を持ちているが、の割合を対して使用する場合に、この組合を持ちているが、の割合が表別では、被加工物を持ち、はないなり、はないの上述の大きなもののはは、なり、はないのでは、ないののでは、ないののでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ない

力な除去剤を使用すればコンタクトレンズに光学 的透視歪を発生させる可能性があった。一方、光 学的透視歪を発生させない程度の除去剤(例えば 灯油等)を使用した場合指先でこすりながら接着 剤を除去する必要が生じ、コンタクトレンズ表面 に爪などで攘傷を付けてしまうこともあった。そ して、擦傷の発生を防ぎつつ手作業でコンタクト レンズの表面仕上げを行なおうとすれば、時間と 人手がそれだけかかっていた。その結果、現状で はコンタクトレンズの切削研磨法による製作工程 での不良品の発生率は数10パーセントにも及ぶ 場合があり、このようにコンタクトレンズの製品 不良事が大きいと、製作コストがかまたのみたら ず、生産計画の策定が不安定となり製造メーカー の営業活動にも支障をもたらす可能性もあった。 しかし、本発明の組成物はその易水溶性ゆえにか かる問題を解決することができる。

なお、60℃以上の温度に対しても耐熱性のある被加工物の加工用では、前記ポリエチレングリコール系化合物の割合を40重量部以下としても、

ポリエチレングリコール系化合物の凝固点も被加工物の加工時の温度上昇度とその耐熱性に応じ適宜選択するのが良い。

例えば、コンタクトレンズ素材の加工においては、その研磨用治具との着脱が60℃以下で容易に行なわれることが望ましく、これよりも高光生し度ではコンタクトレンズに光学的透視歪が発生しやすい。このような観点から、60℃以下で被加工物と治異との着脱を行なう必要があるコンタクトレンズのような耐熱性の低い材料の加工用には、組成物中のポリエチレングリコール系化合物と水溶性熱可塑性高分子化合物との割合を、前者40~70重量部、後者60~30重量部とするのが好ましい。

また、本発明の組成物は易水溶性であり、加工されたコンタクトレンズ及び治異からの脱離も水で洗うことにより容易に行なうことができる。従来の接着剤の場合、切削研磨後にレンズ衰面に残留している接着剤を除去するために溶剤や膨張剤等の除去剤を使用する必要があった。その時、強

実用上の着脱作業性を充足させることができる。 この場合、先にも述べたように、本発明の組成物 の軟化流動温度付近での温度上昇に対する剛性率 の変化率はやや小さくなるが、耐熱性のある被加 工物を対象とする限りでは実用上の目的は十分違 成でき、しかも本発明の組成物の易水溶性を損う ものでもない。

水溶性熱可塑性高分子化合物

ポリエチレングリコール系化合物と相溶性を有する水溶性熱可塑性高分子化合物としては、分子中に3級窒素原子及びピニル基又は (メタ) アクリロイル基を単量体単位として含有する高分子化合物が紆適である。

このような単量体単位としては、Nービニルー2ーピロリドン、Nー(メタ)アクリロキシアルキルー2ーピロリドン、Nービニルカプロラクタム等のラクタム構造を有するピニル系又は(メタ)アクリル系モノマー、N、Nージメチルアクリルアミド、N、Nージエチルアクリルアミド等のN、Nージアルキル(メタ)アクリルアミドの他、N、

N-ジメチルアミノエチルアクリルアミド、N. N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、N. N-ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド、 N. Nージメチルアミノプロピルアクリルアミド 塩化メチル4級塩等のN、N-ジアルキルアミノ アルキル(メタ)アクリルアミド及びその塩等の アクリルアミドから誘導されるモノマー、及び、 ジメチルアミノエチルアクリレート塩化メチル4 級塩、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジエ チルアミノエチルメタクリレート等のジアルキル アミノアルキル (メタ) アクリル酸エステル及び その塩等の第3アミノ基又は第4アンモニウム基 を有するモノマーが挙げられる。そのうち、N-ピニルー2ーピロリドン、N- (メタ) アクリロ キシアルキル-2-ピロリドン、N-ピニルカブ ロラクタム等のラクタム構造を有するピニル系又 は (メタ) アクリル系モノマー、N, N-ジメチ ルアクリルアミド、N, N-ジエチルアクリルア ミド等のN,N-ジアルキルアクリルアミドを単 量体単位として含有する高分子化合物がポリエチ

溶融時の粘度が高くなり接着作業性が悪くなる。これに反し、その平均分子量が小さくなるほど本発明組成物の溶融時の接着作業性が良好となるが破壊強度は低下する。したがって、該水溶性高分子化合物の平均分子量の範囲は実用的に自ずと限界があり、数平均分子量として好ましくは800~650,000、さらに好ましくは1,000~60,000のものを用途に応じて使い分けることが望ましい。ビニルピロリドンのホモポリマーは、例えば、

ビニルピロリドンのホモポリマーは、例えば、 大津隆行、木下雅悦共著「高分子合成の実験法」 化学同人社発行、第141頁及び中村亦夫監修 「水溶性高分子」化学工業社発行、第294頁に 示される方法によって製造することができる。ま た、ビニルピロリドンのホモポリマーは、BAS F社よりLuviskolという商品名で販売されている。

ビニルピロリドンのコポリマーは、米国特許第 2,667,473号、同第2,958,614号、英国特許第805. 386号条即網書に記載の方法によって用途に応じ レングリコールとの相溶性に優れているので好ましい。中でも、Nーピニルー2ーピロリドン、Nー(メタ)アクリロキシアルキルー2ーピロリドン等のピロリドン基を有するピニル系又は(メタ)アクリル系モノマーを単量体単位として含有する側鎖にピロリドン基を有する高分子化合物を使用することが好ましい。

本発明で使用する水溶性熱可塑性高分子化合物はこれらのモノマーの1種又は2種以上を通常のの重合方法で重合させることによって得ることができ、さらに、これらのモノマーと他の共重合可能なモノマーとしては、酢酸ビニル、エチルアクリレート等が好ましい。

また、本発明の組成物の水溶性の観点から、上 記単量体単位は該水溶性熱可塑性高分子化合物の 30重量%以上、好ましくは40重量%~100 重量%を構成していることが望ましい。

本発明で使用する水溶性熱可塑性高分子化合物 の分子量は特に限定されない。しかし、一般に、

て各種のものを適宜製造することができる。

ビニルピロリドンとこれと共重合可能なその他の化合物とのコポリマーも、高分子合成技術の通常の知識を有するものであれば、上記文献等を参照して容易に製造できることは言うまでもない。なお、ピニルピロリドンと酢酸ピニルとのコポリマーは、BASF社よりLuviskolという商品名で販売されており、各種の共重合比率のものを入手することができる。

尚、本発明の熱可塑性樹脂組成物においては、 水溶性熱可塑性高分子化合物として、上記各種の ホモポリマー又はコポリマーを単独又は2種以上 混合して使用することができる。

ポリエチレングリコール系化合物

本発明で使用するポリエチレングリコール系化合物としては、各種分子量のポリエチレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリコールジメチルエーテル類、エチレングリコールモノブチルエーテル類を挙げることができるが、軟化流動特

性と接着力のバランスの点からポリエチレングリ コールが好ましい。

ポリエチレングリコールは高分子屋のものほど 組成物の熱流動性が低くなるので分子量が20000 以下、好ましくは10000以下のものを使用するこ とが望ましく、例えば、日本暫建㈱より販売され でいる日曹ポリエチレングリコール#200(凝固点 ~50℃)、#300(凝固点~13℃)、#400(凝固点 6 ℃)、#600(凝固点20.3℃)、#1000(凝固点 点36~40℃)、#1500(凝固点38~41℃)、#1540 (凝固点43~47℃)、#2000(凝固点47~53℃)、#4000(凝固点53~56℃)、#6000(凝固点56~61 ℃)等の種々の製品や、ライオン㈱から販売され ている類似の製品等から用途及びそれに要求され る特性に応じて1種または2種以上のものを適宜 選択して使用することができる。

ポリエチレングリコールを使用した場合、本発明の組成物はその狭い特定の温度域で温度上昇又は下降に伴い、通常の概念での固体から粘性液体へ、又は粘性液体から固体へと画然とした可逆的

合物の配合比率は各種用途目的に応じて自由に設 計することができる。

たとえば、ホットメルト接着剤等の用途では、ポリエチレングリコール系化合物の濃度が大きいほど被加工物と治具等の着脱の作業性が良好になるが、その一方でそれらの接着力及び把持力が低下する傾向を示す。したがって、接着剤等の作業性の要求される用途においては、ポリエチレングリコール系化合物と水溶性熱可塑性高分子化合物との配合比率は、接着作業性と接着力とのパランス上、前者が70~40重量部、後者が30~60重量部であることが好ましい。

一方、耐熱性があり加工時の温度上昇が60℃ を越える被加工物の接着に使用するホットメルト型接着剤を構成する場合には、ポリエチレングリコール系化合物の配合割合を40重量部以下(水溶性高分子化合物60重量部以上)とすることもできる。なお、この場合、上述のように本発明組成物の軟化流動温度付近での温度上昇に対する剛性率の変化率はやや小さくなるが、耐熱性のある被加 な状態変化を顕著に示す。したがって、かかる顕著な凝固・軟化特性の要求されるホットメルト接着剤等の用途にはポリエチレングリコールを使用することが好都合である。

また、使用するポリエチレングリコールの分子 量にしたがって本発明の組成物の軟化流動温度が 定まるので、使用するポリエチレングリコールの 種類を適宜選択することで特定の用途に応じた軟 化流動温度を備えた樹脂組成物を設計することが できる。特に、ホットメルト接着剤等の用途には、 凝固点が約15℃以上、好ましくは約20℃以上のポ リエチレングリコールから適宜選択して使用する ことが課ましい。

配合納合

本発明の熱可塑性樹脂組成物においては、ポリエチレングリコール系化合物の濃度が高いほど温度変化に対する剛性率の変化率が大きくなり、しかも凝固点からの僅かな温度上昇によってそれだけ容易に流動するようになる。これを利用して、本発明の組成物中、ポリエチレングリコール系化

工物を対象とする限りはホットメルト型接着剤として十分使用でき、本発明組成物の易水溶性を損うものでもなく、実用上の目的は十分違成できる。 尚、上記2つの成分からなる本発明の無可塑性 樹脂組成物に対し、必要に応じ顔料等の着色剤、充填剤、強化材及びその他の添加剤を適宜配合することができる。

製造方法

本発明の熱可塑性樹脂組成物は各種の手段を用いてポリエチレングリコール系化合物と水溶性熱可塑性高分子化合物とを必要とされる混合比率で均一となるように溶散及び/又は混合することにより製造することができる。

具体的には、例えば、予め製造された水溶性熱可塑性高分子化合物とポリエチレングリコール系化合物とを必要に応じ加熱して、溶解及び混合することによって製造することもでき(以下、「溶解法」という)、また、ポリエチレングリコール系化合物を溶媒として熱可塑性高分子化合物の構成成分となる単量体を溶液量合することによって

製造することもできる(以下、「重合法」という)。 特に、重合法は、その重合反応の終了時点で本発 明の熱可塑性樹脂組成物を得ることができるので、 溶解法のように熱可塑性高分子化合物の共重合体 の精製工程を必要とせず、省力化を達成できるの で好ましい。

尚、上記重合法において、溶液重合法に関する 生成重合体の分子量の調節、生成共重合体の組成 分布の調節等の当業者に明らかな技術的手法は自 由に活用できることは言うまでもない。

使用方法

本発明の樹脂組成物を接着剤として使用するに当っては、その組成物に希釈溶媒を加えることなくそのまま固体状態或いは溶融状態で治具或いは被加工物に塗布し両者を所定の温度で接着(圧着)する方法と、その組成物に水或いはアルコール等の溶媒を加え溶液状としたものを治異或いは被加工物に塗布し次いでその溶媒を揮発除去した後に両者を所定の温度で接着(圧着)する方法の何れかを目的に応じて用いることができる。その際、

~157頁に記載されている高周波誘動加熱及びマイクロ波誘電加熱の何れの方法も使用できる。これにより、プレートの加熱に要する熱エネルギーを節減するとともに圧着後にプレートを冷却するに要する時間も短縮され、加熱、圧着、冷却に要する設備を簡略化でき、作業場のスペースも縮小される。

(実施例)

以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、 本発明は、この実施例によって何等限定されるも のではない。

実施例1~8

第1 表に示すポリエチレングリコールとピニル ピロリドンのホモポリマーまたはコポリマーとを 間表に示す配合比率で均一になるように溶融混合 して生成物を得た。

これらの生成物の水溶性は、いずれも良好であった。

さらに、この組成物を接着剤A~Hとし、着脱 温度を測定すると共に、以下の接着力試験に供し 小さな被加工物に対してはヘヤードライヤー等を 用いた温風加熱によって本発明の組成物を所定の 温度に簡便に加熱することができる。

特に、本発明のポリエチレングリコールを含有する組成物は誘電加熱され易い材料であり、被接着物が同様に誘電加熱され易い物体である場合には誘電的に加熱することにより接組成物を加熱溶験することができ、熱エネルギーを節減することができる。

たとえば、半導体ウエハの研磨加工においては、 特公平1-40072号公報に記載されているように、ウエハをセラミック等の熱容量の大きいプレート(研磨台(治具))にワックスを用いて貼り合わせ禁止するに際しプレートを120~160℃に加熱している。

本発明では、前記組成物をウエハに塗布、乾燥し、誘電加熱によりプレートに圧着することで両者を接着することができる。誘電加熱の方法としては、東京電気大学出版局発行の『高周波の工業への応用』(以下、「文献3」という)、第156

t.

接着力試験(1)

直径12mm、厚さ5mmの各種コンタクトレンズ 紫材1(一般に、「ボタン」と呼ばれる(上記文 献1、第270頁参照))を板材2(鉄板:材質 SPCC)に対し、上記接着剤A~Hを用いて第1図 に示すようにして貼付し、これを試験片とした。

同様の板材にボタンを収容できる大きさの穴を 関けた関ロ鉄板3を第2図に示すように上記試験 片に被せ、同図に示す方向に荷重をかけることに よって、圧縮剪断破壊応力を測定した。

測定時の雰囲気温度は、25℃、35℃及び45℃と した。

その結果を、第1表に示す。

実施例 9

18 mm の がラス製試験 管中に日本曹連㈱製日 曹ポリエチレングリコール # 1000を 9 gr、 G A F 社製 N - ピニルー 2 - ピロリドンを 8 gr、電気化 学工業㈱製酢酸ピニルを 2 gr、日本ヒドラジン工 業㈱製アゾピスイソブチロニトリルを 0.04 gr 封入 し、次いでこれを水浴中で 6 0 ℃ 4 時間、 7 0 ℃ 2 時間、 9 0 ℃ 2 時間、 さらに空気浴中で 1 1 0 ℃ 2 時間、合計 1 0 時間の間加熱して重合反応を終了した後、室温にて放冷した。

尚、この重合反応の初期において、融解したポリエチレングリコールと他の材料とが均一になるよう充分に試験管を振盪した。

得られた生成物は、良好な水溶性を示した。

この生成物を接着剤」とし、着脱温度を測定すると共に、実施例1と同様にして接着力を測定した。

その結果を第2数に示す。

宴旅例10

日曹ポリエチレングリコール#1000、9 grの代 りに同#1000を4 gr及び同#1540を6 gr使用し、 かつ、ピニルピロリドンを5 gr、酢酸ピニルを5 grとした以外、実施例9と同様にして行った。

得られた生成物は、良好な水溶性を示した。

この生成物を接着剤 K とし、着脱温度を測定すると共に、実施例 1 と同様にして接着力を測定し

この生成物を接着剤Mとし着脱温度を測定する とともに実施例1と同様にして接着力を測定した。 その結果を第2表に示す。

実施例13

日曹ポリエチレングリコール#1000、9 grの代りに同#1540を9 gr、N - ビニルー2 - ピロリドンの代りに隣興人製ジメチルアクリルアミド3 grとし、アゾビスイソプチロニトリルの量を0.02 grとした以外は、実施例9と同様にして行った。

得られた生成物は良好な水溶性を示した。

この生成物を接着剤Nとし着脱温度を測定する とともに実施例1と同様にして接着力を測定した。 その結果を第2表に示す。

実施例14

接着剤 A を使用し、板材 2 を無機ガラス板に代えた以外実施例 1 と同様にしてポリメチルメタクリレート (P M M A) 製ポタンの接着力試験 (1)に供したところ、25℃において26 kgの接着力が得られた。

また、同様にして、真鍮板との接着力を測定し

た。

その結果を第2表に示す。

実施例11

日曹ポリエチレングリコール#1000、9 grの代 りに同#1540を12 gr使用し、かつ、ピニルピロ リドンを3 gr、酢酸ピニルを7 grとした以外、実 施例9と同様にして行った。

得られた生成物は、良好な水溶性を示した。

この生成物を接着刺Lとし、着脱温度を測定すると共に、実施例1と同様にして接着力を測定した。

その結果を第2表に示す。

実施例12

日曹ポリエチレングリコール#1000、9 grの代りに同#1540を1 O gr、Nーピニルー 2 ーピロリドンと酢酸ピニルの代りにBASF社製Nーピニルカプロラクタム 5 grとし、アゾピスイソブチロニトリルの量を0.02 grとした以外は、実施例9と同様にして行った。

得られた生成物は良好な水溶性を示した。

たところ、ほぼ鉄板と同様の結果が得られた。

また、同様にして、上記数種の接着剤について 数種のプラスチック板に対する接着力を測定した ところ下記のような結果となった。

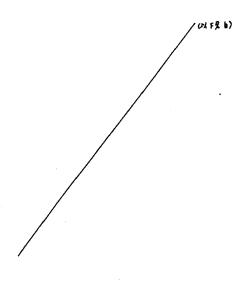
板材	接着材	接着力
ま゛リメチルメタクリレート	接着剤A	2 5 kg
塩化ビニル	接着剂し	1 0 kg
ポリスチレン	接着剤」	1 1 kg
ABS附脂	接着剤A	1 2 kg

比較例1

City Crown社より市販され一般に使用されているコンタクトレンズ用接着剤で在来のロジンワックス系のものよりも接着力が大であるとカタログに記載されているものについて、実施例1と同様にして接着力を測定したところ、25℃では4kg、35℃では8kgであった。

また、この接着剤の溶解時の粘性は本発明品よりも高く、したがって作業性に劣り、また、着脱

可能温度は45~50℃であった。尚、この接着 剤は非水溶性であった。



							無上概									
	原料配合							接着力(kg) (鉄板)								
実施例 接着剤			(重量部)							** 9>=PMMA			#" #>=LD40		* * * * * LDF50	
		VA64	E30	#1000	#1540	#2000	#4000	પ્	25℃	35℃	45℃	25℃	35℃	25℃	35℃	
1	Α	18	_	15	-	_	_	43	16	15	-	14	15	16	15	
2	В	10	-	-	10	_	-	50	12	15	94-7	13	13	12	14	
3	С	10	-	-	15	-		50	11	13	18-7	11	14	10	15	
4	D	10	-	2	8	_	-	50	14	15	94-7	13	14	14	14	
5	E	10	-	_	-	10		55	10	15	11-7	-	-	-	-	
6	F	10	_	4	-	7	-	55	12	14	14-7	-	-	-	-	
7	G	10	-	4	-	_	8	58	12	16	15	-	-	_	Ţ <u>-</u>	
8	н	_	10	15	_	_	_	46	10	13	-	10	11	10	12	

第2表

		原料配合						着脱	接着力(kg) (鉄板)							
実施例	接着剤		(重量部)						温度	*' •' •' PM	N/A		* <i>9</i> y=	LD40	* <i>9</i> y=	LDF50
		V P	VCL	DKAA	VAc	#1000	#1540	AIBN	r	25℃	35℃	45℃	25℃	35℃	25℃	35℃
9	J	8	-	-	2	9	_	0.04	43	13	14	-	14	13	14	14
10	к	5	-	-	5	4	6	0.04	50	14	15	クリーフ*	13	15	15	14
11	L	3	-	-	7	_	12	0.04	48	15	14	19-7°	13	14	12	15
12	М	-	5	-	-	-	10	0.02	48	12	13	タリーフ *	13	13	14	12
13	N	-	-	3	2	_	9	0.02	48	14	14	クリーフ	13	14	.13	12

註) VP: ピニルピロリドン

VP: ピニルピロリドン
VAc: 酢酸ピニル
VCL: Nーピニルカプロラクタム
DMAA: ジメチルアグリルアミド
#1000、1540: 日曹ポリエチレングリコール#1000、1540(日本曹達㈱製)
AIBN: アゾピスインプチロニトリル
#197=PMAA : ポリメチルメタクリレート製ポタン
#197=LD40 : Lamda Opticai社製LD40 (ポリメチルメタクリレート/シリコーン共重合体製ポタン)
#197=LDF50: Lamda Opticai社製LDF50 (フルオロカーポン/シリコーン/アクリレート製ポタン)
尚、着脱温度は、接着力試験片の板材とポタン(第1図参照)との着脱を手圧で容易に行える接着剤の温度を測定した。

以下、本発明の組成物を半導体ウェハ繋止用の ホットメルト型接着剤として供した実施例を示す。 なお、以下で調製した接着剤の接着性能は下記 の試験方法によって評価した。

接着力試験(2)

熱風炉中で120℃に加熱されている2枚のセ ラミック板 6. 6° (20×30×5(m/m)) 各々の片 面に、同一の固形接着剤7, 7'を4~5μmの 厚みに塗布する。このセラミック板6、6°の接 着剤膜7、7′の間にシリコンウエハ5 (10×10 (m/m)) を第3図(a)に示すように挟み、無風乾燥 炉の120℃の温風中で10分間加熱した後、直 ちに20grの天秤分銅を第3図(b)に示すように セラミック板6の上に載せたままセラミック板が 室温になるまで室温で放冷し、これを試験片とす

この試験片に対して、第3図(c)の矢印で示す 方向に荷重をかけることによって接着剤の25℃ における圧縮剪断破壊応力及び所定温度における 塑性流動の降伏値を測定した。また、この試験片

のセラミック板とシリコンウエハを手圧で容易に 着脱できる接着剤の温度を測定した。

接着力試験(3)

2枚のセラミック板 6 (20×30×5(m/m)) 各々の片面に同一の溶液状接着剤で、で、を20 μmの厚みに塗布し、熱風乾燥炉の100℃の熱 風中で10分間乾燥した後、室温で放冷する。

このセラミック板 6, 6' の接着剤膜 7, 7' の間にシリコンウエハ 5 (10×10(m/m)) を第3 図(a)に示すように挟み、熱風乾燥炉の120℃ の熱風中で10分間加熱する。

その後直ちに20grの天秤分絹8を第3図(b) に示すようにセラミック板6の上に載せ、そのま まセラミック板が室温になるまで室温で放冷し、 これをは験片とする。

この試験片に対して第3図(c)の矢印で示す方 向に荷重をかけることによって接着剤の25℃に おける圧縮剪断破壊応力及び所定温度における塑 性流動の降伏値を測定する。また、この試験片の セラミック板とシリコンウエハとの着脱を手圧で 容易に行なえる接着剤の温度(着脱温度)を測定する。

接着力試験(4)

第3図(a)に示す状態の試験片を無風乾燥炉の 無風中で加熱する代りに、東芝電子レンジER-225 (高周波出力200W相当)中でマイクロ波を15 秒間照射後、直ちに20gTの天秤分綱を第3図(b) に示すようにセラミック板6の上に載せ、その分 綱を2分後に除去し、これを試験片とする。この 試験片について、接着力試験(3)と同様にして圧 縮剪断破壊応力、所定温度における塑性流動の降 伏値及び着脱温度を測定する。

実施例15

Luviskol VA64 1 0 gr、日曹ポリエチレング リコール#2000 1 0 gr、同#6000 3 grを用い、 均一になるように溶融混合して生成物を得た。こ の生成物は良好な水溶性を示した。この固形接着 剤をS-1とする。

この接着剤の接着性能を接着力試験(2)で評価 した。その結果を第3表に示す。

さらに、この溶液状の接着剤S-2の接着性能を 接着力試験(3)及び(4)で評価した。その結果を第 3 表に示す。尚、この接着剤S-2はシリコンウエ ハから水で容易に洗い流すことができた。

実施例17

Luvisko1 VA64 1 0 gr、日 古 ポリエチレング リコール # 1000 4 grをメチルアルコール 4 2 grに 溶解し、溶液状の接着剤 S-3 とした。

この接着性能を接着力試験(4)で評価した。その結果を第3 表に示す。尚、この接着剤S-3はシリコンウエハから水で容易に洗い流すことができた。

実施例18

Luviskol VA64 1 Ogr、日曹ポリエチレング リコール#400 3 grをメチルアルコール 39gr に溶解し、溶液状の接着剤S-4とした。

この接着性能を接着力試験(3)で評価した。その結果を第3表に示す。尚、この接着剤S-4はシリコンウエハから水で容易に洗い流すことができ

実施例16

実施例 1 5 で得た接着剤 S-I 1 0 grをメチル アルコール 3 0 grに溶解し、溶液状の接着剤 S-2 とした。

この溶液状の接着剤S-2をシリコンウエハ (10 ×10(m/m)) の片面に 2 0 μm の厚さに塗布し熱 風乾燥炉の100℃の熱風中で10分間乾燥した のち、室温で放冷した。第4図(a)に示すように、 このシリコンウエハ5の接着剤乾燥膜7を下にし てセラミック板6 (20×30×5(m/m)) 上に置き、 南芝電子レンジRR-225 (高層液出力200W相当) 中でマイクロ波を10秒間照射した。その後直ち に、第4図(b)に示すように、20grの天祥分銅8 をシリコンウエハ5の上に載せ、2分後にその分 網8を除去した。その結果、シリコンウエハ5は しっかり密着しており、その端部に安全カミソリ の刃を当てシリコンウエハ5をセラミック板6上 より剥離したところ接着剤層7とセラミック板6 又はシリコンウエハ5との間の界面破壊と接着材 層の凝集破壊が観察された。

参考例1

ジメチルアクリルアミド400gr及びエチルアクリレート100grを攪拌機、還流コンデンサー及び湿度計を備えた2 Qフラスコ中で無水のエチルアルコール400gr中に室温で溶解した。次・アルコールの連点にまで加熱する。次にし、各 T ルコールの連点にまで加熱する。次にし、各 T ルコールので、フラスコ内を窒素がスで浄化し内温をエチゾアチロニトリル0、5grを添加して、各 T ルフブチロニトリル0、5grを添加して、各 T 中間の1階でこのを加を4回繰り返して重合し、ジボルアクリルアミドとエチルアクリレートのコポリマーのエチルアルコール溶液(A)を得た。

この溶液(A)にメチルアルコール1100grを加え、溶液状の接着剤Tとした(25%固形分)。 第3表に示すように、この接着剤Tは120℃ でも軟化せず、120℃以下では接着剤としての 使用に供し得なかった。但し、この接着剤Tは良 好な水溶性を示した。

実施例19

上記の溶液(A)5 Ogrに日本曹連㈱製ポリエチ レングリコール # 2000の 2 5 %メチルアルコール 溶液18grを加え混合溶解し、接着剤S-5を得た。

この接着剤S-5の接着性能を接着力試験(3)で評 価した。その結果を第3表に示す。尚、この接着 刺はシリコンウエハから水で容易に洗い流すこと ができた。

比較例 2

半導体研磨加工工程におけるプレートとシリコ ンウエハとの繋止用接着剤として市販されている 日化精工傚製SKYWAX M-1 (「接着剤U-2」と呼ぶ)の接着性能を、接着力試験(2)で評価 した。その結果を第3表に示す。尚、この接着剤 は非水溶性であった。

上較例3

上記SKYWAX25grをトリクロロエタン75 grに溶解し、溶液状の接着剤U-3とした。

この接着剤 以-3の接着性能を接着力試験(3)にし たがって評価した。その結果を第3表に示す。尚、 この接着剤は非水溶性であった。

第3表

実施例	接着剤		剪断破壊応力 (kg/cm²)	塑性	着脱湿皮	使用した 接着力試験			
	種類	PEG比	25℃	56℃	60°C	70℃	80°C	(°C)	番号*
15	S-1	56%	3 7	500 >	20 >	10>	-	6 0	(2)
16	S-2 S-2	5 6 % 5 6 %	3 8 4 1	500 > 500 >	20 > 20 >	10 > 10 >	=	6 0 6 0	. (3)
17	S-3	29%	3 5	1000>	1000>	100>	_	100	(4)
18.	S-4	23%	3 0	_	_	1000>	500>	1 2 0	(3)
19	S-5	26%	3 2	-	_	-	1000>	1 2 0	(3)
参 − 1	Т	_	-	-	-	-	-	120℃で不可	_
比-2	U-2	-	2 8	50 >	10>	5 >	_	5 8	(2)
比-3	U-3	_	2 6	50>	10 >	5>	-	5 8	(3)

註1) PEG比 (%) = (ポリエチレングリコールの量) / ((ポリエチレングリコールの量) + (水溶性無可塑性高分子化合物)) 註2) *:接着力試験(2)=(固形接着刺煙布→無風乾燥→無風加熱→室温冷却) 接着力試験(3)=(溶液状接着刺煙布→無風乾燥→無風加熱→室温冷却) 接着力試験(4)=(溶液状接着刺煙布→無風乾燥→マルの一変温冷却) 註3) 看脱温度は、試験片のセラミック板とシリコンウエハ(第3図参照)との着脱を手圧で容易に行なえる接着刺の温度を測定した。

以上から、本発明の熱可塑性樹脂組成物は、良好な熱可塑性と水溶性を示し、かかる物性故に各種の広範な用途に適用できることがわかる。

また、本発明の熱可塑性樹脂組成物はガラス、金属、ブラスチック等の各種の素材に対して良好な接着力を有し、特に、従来のコンタクトレンズ切削研磨工程で使用されている繋止剤の接着力は10kg以下であると考えられるのに対し、それ以上の水準にあり、十分実用に耐え得るものであることがわかる。また、本発明の無可塑性樹脂組成物は従来使用されていた半導体ウェハの研磨切削工程で使用されていた繋止剤よりも優れた接着力を示している。

また、本発明の熱可塑性樹脂組成物は水溶性であるため、コンタクトレンズの切削研磨工程後はレンズ表面を損傷すること無く水で容易に洗い流すことができる。したがって、コンタクトレンズ切削研磨加工に使用されるホットメルト接着剤の原料として好適であり、しかも、その軟化流動温度を低温に設計することができるため、耐熱性が

全ての用途目的に適用できる製造方法の規定を設けることは不可能である。しかし、当業者であれば、本明細書の開示内容を参考にして、個々の用途目的に応じた組成物を製造しその効果を試験、確認することは容易であるから、そのような組成物は全て本発明に包含されると解釈しなければならない。

4.図面の簡単な説明

第1 図は、本実施例及び比較例で使用した接着力試験(1)用試験片を説明する概略斜視図であり、第2 図(a)及び(b)は、本実施例及び比較例で行なった接着力試験(1)を説明する概略の側断面図及び平面図であり、第3 図(a)、(b)及び(c)は本実施例及び比較例で行なった接着力試験(2)~(4)を説明する概略の側面図であり、第4 図(a)及び(b)は実施例16で用いた剥離試験を説明する概略の側断面図である。

尚、図面中、

1 … ポタン、2 … 板材、3 … 開口板材、4 … 接着 剤、5 … シリコンウエハ、6, 6′ … セラミック 劣るために在来の接着剤が適用できなかった光学 的、生理的により高性能のプラスチック製コンタ クトレンズ材料にも適用することができる。

また、本発明の熱可塑性樹脂組成物はアルコール可溶性であるため、ホットメルト型接着剤の他、アルコール等に溶かした溶液状の接着剤として使用することもでき、他の有害な溶媒の使用は不要である。

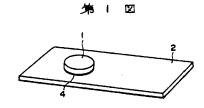
さらに、本発明の熱可塑性樹脂組成物は誘電加 熱され易いため、半導体ウエハ、賃金属等の被接 着物の接着も誘電加熱を利用して容易に行なうこ とができる。

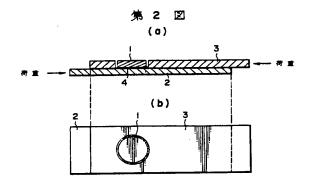
さらに、本発明の無可塑性樹脂組成物は、水に容易に溶解分散する。したがって、本発明の無可塑性樹脂組成物は、目的により水に溶かすことのあるその他各種製品の原料として使用できる。

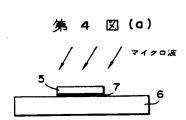
尚、本発明の無可塑性樹脂組成物は各種の用途 目的に対して適用できることは明らかであり、個々の用途目的に適する性質を持った組成物の製造 は互に作用する多くの因子に関係するものであり、

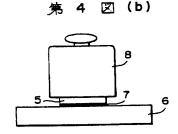
板、7, 7 …接着剤、8 …分網である。 代理人 三宅 正夫 (他1名)

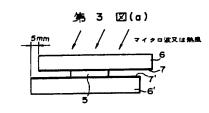
特開平3-79671 (13)

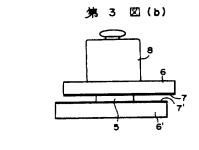


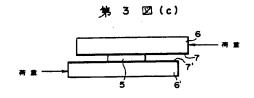












手統 補正 誓(自発) 平成2年7月25日

特許庁長官殿

1 事件の表示

-平成2年特許願第69569号

2 発明の名称

熱可塑性樹脂組成物

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

氏名 末次雅夫

4 代理 人〒100

住所 東京都千代田区有梁町1丁目7番1号

氏名 (5930)弁理士 三 宅 正 夫 (他1名)

- 5 補正命令の日付 自発
- 6 補正により増加する発明の数 0
- 7 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄 』

8 補正の内容



- (1) 明細書第8頁下から2行目の「影張剤」を 「影顔剤」に訂正する。
- (2) 同第10頁第14行~第11頁第13行の 「このような単量体----モノマーが挙げられる。」を下記に訂正する。

「このような単量体としては、ラクタム構造を有するピニル系又は (メタ) アクリル系モノマー及び第3アミノ基又は第4アンモニウム基を有するピニル系又は (メタ) アクリル系モノマーが挙げられる。

ラクタム構造を有するビニル系又は(メタ)アクリル系モノマーとしては、Nービニルー2ーピロリドン、Nー(メタ)アクリロキシアルキルー2ーピロリドン、Nービニルカプロラクタム等を挙げることができる。

第 3 アミノ基又は第 4 アンモニウム基を有する ピニル系又は (メタ) アクリル系モノマーとして は、アクリルアミドから誘導されるモノマー、例 えば、N, Nージメチルアクリルアミド、N, N ージエチルアクリルアミド等のN, Nージアルキ

- (7) 同第33買下から2行目の「接着材」を 「接着剤」に訂正する。
- (8)同第37頁の第3表を別紙のとおり訂正す る。

ル (メタ) アクリルアミドの他、N, N-ジメチルアミノエチルアクリルアミド、N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド塩化メチル4級塩等のN, N-ジアルキルアミノアルキル(メタ)アクリルアミド及びその塩が挙げられ、アクリル酸エステル及びその塩、例えば、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジエチルイシエチルアシリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート。ジエチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート。ジエチルアミノエチルアラリレート。ジエチルアミノエチルアクリレート。ジエチルアミノエチルアクリレート。ジエチルアミノエチルアラリレート。ジエチルアミノエチルアクリレート。ジエチルマミノエチルメタクリレート等を挙げることができる。

- 融」に打正する。 (4) 同第18頁下から4~3行目の「溶解法」
- (5) 同第21 莨第1 行の「誘動加熱」を「誘電 加熱」に訂正する。

を「溶融法」に訂正する。

(6) 同第26頁下から2行目の「溶解時」を 「融解時」に訂正する。

第3表

実施例	接	着刺	剪断破墟応力 (kg/cm²)	塑性	着脱温度 (℃)	使用した 接着力試験 番号*			
	種類	PEGH	25℃	56℃	60℃	70℃	80℃	(0)	• ,
15	S-1	56%	3 7	500>	20>	10>	-	6 0	(2)
16	S-2 S-2	5 6 % 5 6 %	3 8 4 1	500 > 500 >	20 > 20 >	10 > 10 >	=	6 0 6 0	(3) (4)
17	S-3	29%	3 5	1000>	1000>	100>	-	100	(4)
18	S-4	23%	3 0	-	_	1000>	500>	1 2 0	(3)
19	S-5	26%	3 2	-	_	-	1000>	120	(3)
# - 1	т	_	_	 -		-	-	1 2 0℃で不可	-
比-2	U-2	_	2 8	50>	10>	5>	_	5 8	(2)
比-3	U-3	_	2 6	50>	10>	5>	-	5 8	(3)

注1) PEG比(%)= [(ポリエチレングリコールの量)/((ポリエチレングリコールの量)+(水溶性無可塑性高分子化合物)))×100 註2) *:接着力試験(2)=(固形接着刺塗布→無風乾燥→無風加無→室温冷却) 接着力試験(3)=(溶液状接着刺塗布→無風乾燥→無風加熱→室温冷却) 接着力試験(4)=(溶液状接着刺塗布→無風乾燥→マイクロ波加熱→室温冷却) 註3)着脱温度は、試験片のセラミック板とシリコンウエハ(第3図参照)との着脱を手圧で容易に行なえる接着剤の温度を測定した。